



平成30年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成29年8月9日

上場会社名 株式会社 岡本工作機械製作所

上場取引所 東

コード番号 6125 URL <http://www.okamoto.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 石井 常路

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 管理本部長 (氏名) 高橋 正弥

TEL 027-385-5800

四半期報告書提出予定日 平成29年8月10日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第1四半期	5,675	40.9	103		68		37	
29年3月期第1四半期	4,027	34.5	444		541		573	

(注) 包括利益 30年3月期第1四半期 111百万円 (%) 29年3月期第1四半期 1,179百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第1四半期	0.85	
29年3月期第1四半期	12.96	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年3月期第1四半期	28,625	9,404	32.9	212.50
29年3月期	28,273	9,470	33.5	213.98

(参考) 自己資本 30年3月期第1四半期 9,404百万円 29年3月期 9,470百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年3月期		0.00		4.00	4.00
30年3月期					
30年3月期(予想)		2.00		30.00	

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施する予定であるため、平成30年3月期(予想)の1株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「-」として記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年3月期(予想)の1株当たり期末配当金は3円となり、1株当たり年間配当金は5円となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

3. 平成30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	13,000	19.2	500	36.5	350	158.8	250	292.7	5.65
通期	28,000	17.9	1,600	40.4	1,350	75.7	1,100	90.5	248.55

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

平成30年3月期の連結業績予想(通期)における1株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年3月期の連結業績予想(通期)における1株当たり当期純利益は24円85銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - 以外の会計方針の変更 : 無
 - 会計上の見積りの変更 : 無
 - 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年3月期1Q	47,178,956 株	29年3月期	47,178,956 株
期末自己株式数	30年3月期1Q	2,924,027 株	29年3月期	2,921,635 株
期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期1Q	44,256,505 株	29年3月期1Q	44,274,587 株

四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(株式併合後の配当及び業績予想について)

当社は、平成29年6月29日開催の第118期定時株主総会において、株式併合について承認可決され、29年10月1日を効力発生日として、普通株式を10株につき1株の割合をもって株式併合を実施する予定であります。なお、株式併合を考慮しない場合の平成30年3月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。

1. 平成30年3月期の配当予想

1株当たり配当金	第2四半期末	2円00銭	期末	3円00銭	年間配当金合計	5円00銭
----------	--------	-------	----	-------	---------	-------
2. 平成30年3月期の連結業績予想

1株当たり当期純利益	第2四半期末(累計)	5円65銭	通期	24円85銭
------------	------------	-------	----	--------

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
3. 補足情報	8
受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、先進国を中心に緩やかな景気回復基調が続きました。米国では個人消費が依然堅調に推移しており、欧州では地政学的リスクの顕在化懸念など、先行きに不透明感があるものの、緩やかな回復傾向にあり、また、アジアでは中国において雇用・所得環境の改善や設備投資の回復による持ち直しの動きがみられました。

日本経済は円安基調が継続しており、輸出関連企業を中心に収益改善の傾向がみられ、個人消費に力強さは欠けるものの、回復基調が続きました。

このような状況の中で当社グループは、中期経営計画「Mission GX 2019」の2年目として、海外販売拠点の増強やQCD改善活動によるコストの削減などをさらに進め、グループの総合力を駆使して、業績向上に努めてまいりました。その結果、当第1四半期連結累計期間における連結売上高は5,675百万円（前年同期比40.9%増）、営業利益は103百万円（前年同期は営業損失444百万円）、経常利益は68百万円（前年同期は経常損失541百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は37百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失573百万円）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりです。

①工作機械

国内市場におきましては、工作機械業界や半導体関連装置業界向けに高精度タイプの研削盤やCNC平面研削盤などの販売が増加し、売上高は前年同期を上回りました。また受注につきましても、半導体関連装置業界の活況が継続していることに加えて「ものづくり補助金」での採択案件が受注に反映されるなど、前年同期を上回る結果となりました。海外市場におきましては、米国では航空機や自動車部品などの業種を中心に販売、受注共に堅調に推移いたしました。欧州では、英国のEU離脱問題や中東リスクの継続など不安材料はあるものの景気は安定しており、売上高は若干前年同期を下回りましたが、フランス、イタリアなどのラテン諸国で汎用タイプの平面研削盤の受注が増加いたしました。アジアにおきまして、中国は電気部品向け精密金型や自動化設備などへの投資需要が回復しており、売上、受注共に前年同期を上回りました。

以上の結果、売上高は4,623百万円（前年同期比25.2%増）、セグメント利益（営業利益）は126百万円（前年同期はセグメント損失193百万円）となりました。

②半導体関連装置

半導体市場におきましては、ウェーハ、デバイス生産メーカーによる設備投資が好調な韓国や台湾、政府支援による半導体関連投資が続く中国など、アジアを中心に前期に続いて回復基調で推移いたしました。半導体関連装置の需要につきましても、海外での設備投資を中心に堅調に推移いたしました。

そのような状況の中で、当社グループは、ポリッシュ装置の重点販売、次世代パワー半導体用各種装置の拡販などの施策を進めた結果、海外市場では中国及びアジアにおいて、ウェーハ生産用のファイナルポリッシャーやグラインダー、デバイス生産用にバックグラインダーなどの販売が好調でした。国内では、光学部品生産の用途でスライサーを販売いたしました。

一方受注の状況ですが、ウェーハ需要回復への対応で投資意欲が旺盛な中国及びアジアにおいて、ファイナルポリッシャーやグラインダー、デバイス生産用にバックグラインダーなどの受注が増加いたしました。また米国や欧州におきましてもファイナルポリッシャーをリピート受注するなど好調に推移いたしました。

以上の結果、売上高は1,051百万円（前年同期比214.6%増）、セグメント利益（営業利益）は184百万円（前年同期はセグメント損失61百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して352百万円増加し、28,625百万円となりました。主な要因は、現金及び預金1,103百万円、たな卸資産が702百万円、有形固定資産が102百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が1,670百万円減少したことによるものであります。

当第1四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して418百万円増加し、19,221百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が286百万円増加したことによるものであります。

また、純資産は、前連結会計年度末と比較して65百万円減少し、9,404百万円となりました。主な要因は、為替換算調整勘定が70百万円、利益剰余金が、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により37百万円増加した一方で、配当金の支払いにより、177百万円減少したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の33.5%から32.9%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績につきましては、平成29年5月15日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,699	4,803
受取手形及び売掛金	7,661	5,991
商品及び製品	1,720	1,971
仕掛品	2,364	2,762
原材料及び貯蔵品	2,387	2,440
その他	425	543
貸倒引当金	△25	△28
流動資産合計	18,233	18,484
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,926	3,901
機械装置及び運搬具(純額)	2,291	2,242
その他(純額)	3,315	3,491
有形固定資産合計	9,533	9,636
無形固定資産	97	88
投資その他の資産		
投資有価証券	103	109
その他	376	381
貸倒引当金	△70	△73
投資その他の資産合計	409	417
固定資産合計	10,040	10,141
資産合計	28,273	28,625
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,523	2,809
短期借入金	7,327	7,572
1年内返済予定の長期借入金	2,075	1,853
未払法人税等	101	107
賞与引当金	263	183
製品保証引当金	39	37
その他	1,463	1,932
流動負債合計	13,793	14,496
固定負債		
長期借入金	3,541	3,293
退職給付に係る負債	493	465
資産除去債務	127	120
その他	846	846
固定負債合計	5,009	4,724
負債合計	18,803	19,221

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,880	4,880
利益剰余金	6,493	6,353
自己株式	△1,358	△1,359
株主資本合計	10,015	9,875
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	16	20
為替換算調整勘定	△698	△627
退職給付に係る調整累計額	136	135
その他の包括利益累計額合計	△544	△470
純資産合計	9,470	9,404
負債純資産合計	28,273	28,625

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
売上高	4,027	5,675
売上原価	3,080	3,979
売上総利益	947	1,696
販売費及び一般管理費	1,392	1,593
営業利益又は営業損失(△)	△444	103
営業外収益		
受取利息	1	0
受取配当金	1	1
助成金収入	9	12
物品売却益	1	3
為替差益	—	18
その他	15	11
営業外収益合計	28	48
営業外費用		
支払利息	72	67
為替差損	31	—
その他	20	16
営業外費用合計	124	83
経常利益又は経常損失(△)	△541	68
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△541	68
法人税等	32	30
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△573	37
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△573	37

(四半期連結包括利益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△573	37
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△8	4
為替換算調整勘定	△596	70
退職給付に係る調整額	△0	△0
その他の包括利益合計	△605	74
四半期包括利益	△1,179	111
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,179	111

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

- I 前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	工作機械	半導体 関連装置	計		
売上高					
外部顧客への売上高	3,693	334	4,027	—	4,027
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	3,693	334	4,027	—	4,027
セグメント損失	△193	△61	△255	△189	△444

(注) 1. セグメント損失の調整額△189百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

- II 当第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	工作機械	半導体 関連装置	計		
売上高					
外部顧客への売上高	4,623	1,051	5,675	—	5,675
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	4,623	1,051	5,675	—	5,675
セグメント利益	126	184	311	△207	103

(注) 1. セグメント利益の調整額△207百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 補足情報

受注及び販売の状況

(1) 受注状況

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
工作機械	6,054	124.2	6,240	112.9
半導体関連装置	2,745	435.1	3,535	358.1
合計	8,799	159.8	9,776	150.1

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 販売実績

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同期比 (%)
工作機械	4,623	125.2
半導体関連装置	1,051	314.6
合計	5,675	140.9

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。